

## บทที่ 2

### หลักการและทฤษฎี

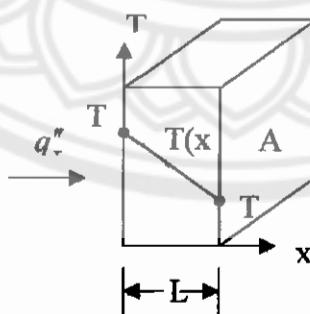
#### 2.1) ทฤษฎีการถ่ายเทความร้อน

การศึกษาการถ่ายเทความร้อนมีทั้งสิ้น 3 แบบ ได้แก่ การนำความร้อน (Conduction heat transfer) การพาความร้อน (Convection heat transfer) และการแผ่รังสีความร้อน (Radiation heat transfer) โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### การนำความร้อน

การนำความร้อน หมายถึง การส่งถ่ายพลังงานความร้อนที่เกิดขึ้นในตัวกลาง อัตราการถ่ายเทความร้อนผ่านตัวกลาง จากด้านที่มีอุณหภูมิสูงไปสู่ด้านที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า การนำความร้อนสามารถเกิดขึ้นในตัวกลางที่เป็นของแข็ง ของเหลว และก๊าซ อัตราการถ่ายเทความร้อนผ่านตัวกลาง แบบการนำความร้อน คำนวณจากกฎของฟูเรียร์ (Fourier's law)

กฎของฟูเรียร์กล่าวว่า การนำความร้อนผ่านตัวกลางในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง อัตราการถ่ายเทความร้อน ( $Q_x$ ) ผ่านตัวกลางในทิศทางนั้น เป็นปฏิกิยาโดยตรงกับพื้นที่ถ่ายเทความร้อน ที่ตั้งฉากกับทิศทางของการไหลของความร้อน ( $A$ ) และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของตัวกลางในทิศทางคั่งกล่าว ( $dT/dx$ )



รูปที่ 2.1 การนำความร้อนผ่านตัวกลางใน 1 มิติพิกัด x

ฟลักซ์ความร้อนผ่านตัวกลางสามารถคำนวณได้จาก

$$q''_x = -k \frac{dT}{dx} \quad (2.1)$$

$q''_x$  = พลังค์ความร้อน ( $\text{W}/\text{m}^2$ )

$K$  = ค่าสภาพนำไฟฟ้า (thermal conductivity) ( $\text{W}/\text{m}^2 \cdot \text{K}$ )

ภายใต้สภาวะคงตัวและตัวกล่างมี  $k$  เป็นค่าคงที่ อุณหภูมิ  $T(x)$  เป็นฟังก์ชันเชิงเส้นดังรูปที่ 2.1

$$\text{ดังนี้} \quad q''_x = \frac{k(T_1 - T_2)}{L} \quad (2.2)$$

สามารถคำนวณอัตราการนำความร้อนทั่วหมาบนพื้นผิว  $A$  จาก

$$\dot{Q}_x = \frac{kA(T_1 - T_2)}{L} \quad (2.3)$$

$\dot{Q}_x$  = อัตราการถ่ายเทความร้อน (W)

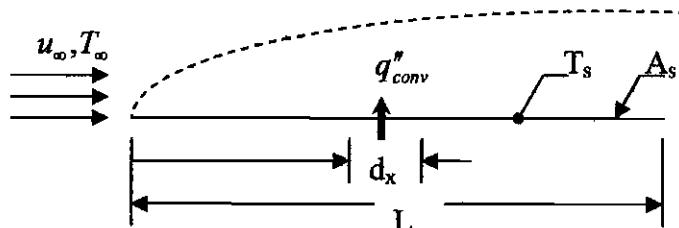
### การพาความร้อน

การถ่ายเทความร้อนโดยการพาความร้อน หมายถึง การถ่ายเทความร้อนระหว่างผิวของแข็งกับของไหหลอด ส่งผลให้เกิดการถ่ายเทโมเมนตัม ซึ่งมีผลต่อสัมประสิทธิ์การพาความร้อนที่ผิวของแข็งนี้ ( $h$ ) พลังงานความร้อนถูกถ่ายโอนเป็นพลมาจาก การแพร่ของไอนีกุล และผลจากการเคลื่อนไหวไปทั้งปริมาตรของไหหลอด ซึ่งสามารถแบ่งการถ่ายเทความร้อนโดยการพาเป็น 2 ชนิดดังนี้

1. การพาความร้อนตามธรรมชาติ (Free Convection) คือ การไหลของไหหลอดจากความแตกต่างของความหนาแน่นของไหหลอด โดยเป็นผลมาจากการอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไป

2. การพาความร้อนโดยบังคับ (Force Convection) คือการไหลของไหหลอดที่เกิดจากแรงภายในอกมากระทำ เช่น แรงที่เกิดจากพัดลม เครื่องสูบ ฯลฯ

จากรูปที่ 2 พิจารณาการพาความร้อนจากผิวของแข็งพื้นที่  $A_s$  อุณหภูมิผิว  $T_s$  บนของไหหลอดผ่านด้วยความเร็ว  $U_\infty$  และอุณหภูมิ  $T_\infty$  คงที่ ความร้อนเฉพาะที่คำนวณ เป็นไปตามกฎการทำให้เย็นตัวลงของนิวตัน (Newton's law of cooling)



รูปที่ 2.2 การพาความร้อนในชั้นชิดผิวความร้อนและชั้นชิดผิวความเร็ว

$$q''_{conv} = h(T_s - T_\infty) \quad (2.4)$$

$h$  = สัมประสิทธิ์การพาความร้อนเฉพาะที่ ( $\text{W/m}^2 \cdot \text{K}$ )

ดังนั้นสามารถคำนวณอัตราการพาความร้อนห้องหมอบนพื้นผิว  $A_s$  จาก

$$\dot{Q}_{conv} = \int_{A_s} q''_{conv} dA_s = (T_s - T_\infty) \int h dA_s \quad (2.5)$$

$$\dot{Q}_{conv} = h_m A_s (T_s - T_\infty) \quad (2.6)$$

$h_m$  = สัมประสิทธิ์การพาความร้อนเฉลี่ย ( $\text{W/m}^2 \cdot \text{K}$ )

### การแผ่รังสีความร้อน

การถ่ายเทความร้อนชนิดนี้จะเป็นลักษณะการเคลื่อนที่ทางแม่เหล็กไฟฟ้าโดยส่องอกมาจากวัตถุในรูปของคลื่นของโมเดกุล อนุภาคพลังงานที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของโมเดกุลเปลี่ยนรูปเป็นการแผ่รังสี ตัวกลางที่มีการแผ่รังสีความร้อนผ่านไปสามารถเป็นไปสามารถเป็นไปได้ทั้งสุญญากาศ ก๊าซ ของไหหล แสงของเชิง ซึ่งวัตถุทุกชนิดมีพลังงานการแผ่รังสีไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและลักษณะผิวน้ำของวัตถุ Stefan - Boltzmann กล่าวว่าวัตถุสีดำ (Blackbody) จะมีพลังงานในการแผ่รังสีเป็นอัตราส่วนกับกำลังสี่ของอุณหภูมิสมบูรณ์ ดังนี้

$$\dot{Q}_{rad} = A \sigma T^4 \quad (2.7)$$

$\sigma$  = Stefan – Boltzmann Constant =  $5.6697 \times 10^{-8} \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}^4$

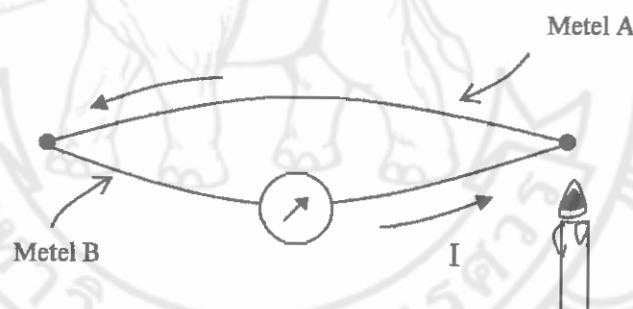
สำหรับวัตถุสีไม่ดำ (Nonblackbody) ซึ่งคุณลักษณะรังสีตัดกระทบได้น้อยกว่า 100% จะมีพลังงานในการแผ่รังสีดังนี้

$$\dot{Q}_{rad} = \epsilon A \sigma T^4 \quad (2.8)$$

$\epsilon$  = คุณสมบัติการแผ่รังสี (Emissivity) โดยที่  $0 < \epsilon < 1$

## 2.2) หลักการทำงานของเทอร์โมอิเล็กทริก

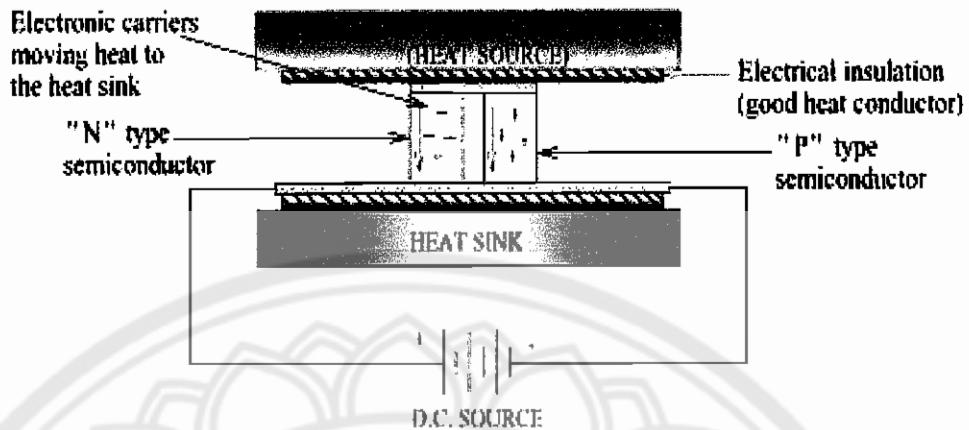
การนำสันลวง 2 เส้นที่ทำจากโลหะที่แตกต่างกัน 2 ชนิด เมื่อนำมาเชื่อมต่อกัน จะทำให้เกิดวงจรปิดดังรูปที่ 2.3 โดยปกติจะไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่ถ้าปลายด้านหนึ่งถูกให้ความร้อน จะมีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นในวงจร ปรากฏการณ์นี้เรียกว่าผลของ Seebeck (Seebeck effect) เพื่อเป็นเกียรติแก่ Thomas Seebeck ผู้ซึ่งค้นพบปรากฏการณ์นี้ในปี ค.ศ. 1821 ถ้า Seebeck สามารถขอนหิศทางการไหลของอิเล็กตรอนในวงจรเหล่านี้ได้ ก็จะสามารถรับประทานพลังงานจากภายนอกในทิศทางที่ย้อนกลับ) เพื่อให้เกิดผลของการควบรวมการทำความเย็นขึ้น แต่ปรากฏการณ์นี้กลับไม่ได้ถูกค้นพบโดย Seebeck แต่ผู้ค้นพบปรากฏการณ์นี้คือ Jean Charles Athanase Peltier ซึ่งค้นพบในปี ค.ศ. 1834 เขายังสังเกตพบว่าในระหว่างที่เขาทำการทดลองปล่อยกระแสไฟฟ้าจำนวนเล็กน้อยให้ไหลผ่านเส้นลวด 2 ชนิด ที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน ที่รอยต่อด้านหนึ่งจะเย็นลง ดังแสดงในรูป 2.4 เราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า ผลของ Peltier (Peltier effect) และเป็นผลทำให้เกิดระบบทำความเย็นเทอร์โมอิเล็กทริก (thermoelectric refrigeration) ขึ้น



รูปที่ 2.3 เมื่อปalyด้านหนึ่งของโลหะ 2 ชนิดที่เชื่อมต่อกันถูกให้ความร้อน ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลในวงจรปิดขึ้น



รูปที่ 2.4 เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านวัสดุ 2 ชนิดที่เชื่อมต่อกันที่รอยต่อด้านหนึ่งจะเย็นตัวลง



รูปที่ 2.5 แสดงส่วนประกอบของเทอร์โมอิเล็กทริก

ส่วนประกอบของเทอร์โมอิเล็กทริก ประกอบด้วย แผ่น เซรามิกบาง ๆ 2 แผ่นทำหน้าที่ป้องกันการหลุดของกระแสไฟฟ้าออกมายานอก และภายในประกอบด้วยวัสดุที่ทำจากสารกึ่งตัวนำทางไฟฟ้า (Bismuth-telluride) แบบ พี-เอ็น (P-N Type) เมื่อเราจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปภายในจะร้อนขึ้น ทำให้สารกึ่งตัวนำทางชนิดกันเกิดการดูดกลืนของอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่จากพลังงานระดับต่ำในสารกึ่งตัวนำแบบพี สูพลังงานระดับสูงในสารกึ่งตัวนำแบบเอ็น ผลให้เกิดการดูดกลืนความร้อนที่ ด้านเย็น (Heat absorbed at cold side) และในขณะเดียวกันก็เกิดการดูดกลืนของอิเล็กตรอนเคลื่อนที่

จากพลังงานระดับสูงในสารกึ่งตัวนำแบบเอ็น สูพลังงานระดับต่ำในสารกึ่งตัวนำแบบพี ผลให้เกิดการถ่ายความร้อนที่ ด้านร้อน (Heat rejected at hot side)

อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก สามารถนำมายield ให้เพื่อทำความร้อน หรือทำความเย็นได้ โดยที่อยู่กับพิเศษของกระแสไฟฟ้าที่เราจ่ายให้กับวงจร ในกรณีที่เราต้องการใช้งานในสภาพการทำความเย็น อันดับแรกที่ต้องพิจารณาคือด้านที่ต้องการทำความเย็นนั้นว่าสามารถดูดซับและถ่ายเทความร้อนออกเพียงพอหรือไม่ เพราะว่า อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก จะมีความร้อนเกิดขึ้นภายในตัวอุปกรณ์เองด้วย

ตัวแปรสำคัญที่ส่งผลต่อเทอร์โมอิเล็กทริกมีอยู่ด้วยกัน 3 ตัวแปร คือ 1)  $T_h$  อุณหภูมิของแผ่นด้านร้อน 2)  $T_c$  อุณหภูมิของแผ่นด้านเย็น 3)  $Q_c$  ความร้อนที่ดูดซับจากด้านเย็น

เมื่อเราจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับในวงจรของเทอร์โมอิเล็กทริก ความร้อนจะถูกปล่อยออกมาย่างด้านร้อนของเทอร์โมอิเล็กทริกและถ่ายเทไปยัง Heat sink ต่อไป โดยใช้อากาศเป็นตัว

ระบบความร้อนของจาก Heat sink จะเป็นแบบธรรมชาติหรือแบบบังคับได้ ทำให้เราหาค่า  $T_h$  ได้จากการสมการ (2.9) และ (2.10)

$$T_h = T_{amb} + (R)Q_h \quad (2.9)$$

$T_h$  = อุณหภูมิของแผ่นด้านร้อน ( $^{\circ}\text{C}$ )

$T_{amb}$  = อุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ( $^{\circ}\text{C}$ )

$R$  = ค่าความต้านทาน ความร้อนของการแลกเปลี่ยนความร้อน ( $^{\circ}\text{C}/\text{watt}$ )

$Q_h$  = ความร้อนที่ถูกถ่ายเทอออกจากด้านร้อน (watt)

$$Q_h = Q_c + P_{in} \quad (2.10)$$

$Q_c$  = ความร้อนที่ถูกซับจากด้านเย็น (watt)

$P_{in}$  = กระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้เทอร์โนมอเล็กทริก (watt)

การที่เราติดตั้ง Heat sink เพื่อระบบความร้อนนี้ ทำให้เกิดการต้านทานความร้อนขึ้น ถ้าไม่ทราบค่าความต้านทานความร้อนบริเวณนี้ ให้ประมาณค่าอุณหภูมิซึ่งสูงกว่าอุณหภูมิโดยรอบตามชนิดของการถ่ายเทความร้อนได้ดังนี้

1. การพากความร้อนแบบธรรมชาติ  $20^{\circ}\text{C} - 40^{\circ}\text{C}$
2. การพากความร้อนแบบบังคับ  $10^{\circ}\text{C} - 15^{\circ}\text{C}$
3. การใช้ของเหลว(Liquid cooling)  $2^{\circ}\text{C} - 5^{\circ}\text{C}$

(ที่มา: Melcor Corporation, Thermoelectric Handbook, Sept., 1995)

Heat sink เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ ถ้ามีขนาดเด็กจนเกินไปก็จะส่งผลต่อการทำงานของด้านเย็น ของอุปกรณ์เทอร์โนมอเล็กทริก หมายความว่า ด้านเย็นอาจจะไม่สามารถดูดซับความร้อนได้เลย

เมื่อเราดึงการทำความเย็นให้กับวัตถุ สิ่งที่จำเป็นคือ แผ่นด้านเย็นต้องมีอุณหภูมิต่ำกว่า อุณหภูมิของวัตถุที่เราจะทำความเย็น อุณหภูมิที่แตกต่างของด้านร้อนและด้านเย็นหาได้จากการ

(2.11)

$$\Delta T = T_h - T_c \quad (2.11)$$

การหาค่า Q<sub>c</sub> หรือค่าความร้อนที่ด้านเย็นของเทอร์โมอิเล็กทริก สามารถหาค่าที่แท้จริงได้จาก เนื่องจากค่าความร้อนที่เกิดขึ้นทั้งหมดต้องนำมาพิจารณาด้วย โดยการคำนวณที่เกิดขึ้นนี้มีค่าดังนี้

- 1) ความร้อนจากภายใน: - ภาระความร้อนจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
- 2) ความร้อนจากภายนอก: - การแผ่รังสี (การสูญเสียความร้อนระหว่าง 2 บริเวณที่มีอุณหภูมิ ต่างกัน)
  - การพาความร้อน (การสูญเสีย ความร้อนผ่านอากาศ เกิดขึ้น เมื่ออุณหภูมิของอากาศและวัตถุต่างกัน)
  - การสูญเสียความร้อนบริเวณผิว
  - การสูญเสียจากการนำความร้อน (บริเวณ หน้าสัมผัส)
  - ภาวะชั่วคราว (เกิดจากเวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนอุณหภูมิของวัตถุ)

ตัวแปรอื่น ๆ ที่นำมาพิจารณาคือวัสดุที่ใช้ทำเทอร์โมอิเล็กทริก ต้องมีคุณลักษณะที่เหมาะสมด้วย ถ้าเป็นบริเวณผิวสัมผัสด้านเย็น และด้านร้อนของเทอร์โมอิเล็กทริก ควร มีคุณสมบัติในการนำความร้อนได้ดี เช่น Copper, Aluminum เพื่อที่จะสามารถถ่ายเทความร้อนออกไปได้ดีที่สุด แต่ส่วนประกอบที่เป็นผิวนานควร มีคุณสมบัติในการนำร้อนได้ต่ำ เช่น โฟม, polyurethane เพื่อลดการสูญเสียความร้อน

สิ่งแวดล้อมโดยรอบที่มีผล เช่น ความชื้น ที่เกิดขึ้นบนด้านเย็นของแผ่นเทอร์โมอิเล็กทริก สามารถทำให้เกิดน้ำขลุงได้โดยการปีกผนึก (Seal) โดยรอบอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก เพื่อป้องกัน การสัมผัสนับน้ำ และอากาศโดยตรง ซึ่งจะช่วยลดการผุกร่อน และการถดถ卜ของกระแสไฟฟ้า ซึ่งจะส่งผลต่อการทำงานของเทอร์โมอิเล็กทริก

ตัวแปรอื่น ๆ ที่สำคัญ เช่น กำลังไฟฟ้าจ่ายต้องเหมาะสม ชนิด Heat sink และรวมถึงลักษณะของการใช้งานด้วย